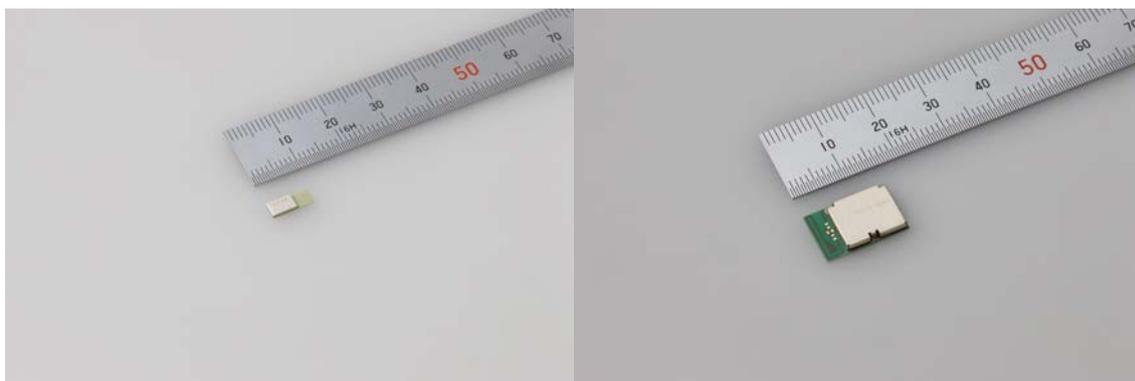


News Release

2018年9月13日

太陽誘電:Bluetooth® 5 対応無線通信モジュールのラインアップ拡充
-ウェアラブル端末など多様化するIoT 関連機器向けに最適提案-



EYSLSNZWW

EYSKBNZWB

太陽誘電株式会社(代表取締役社長:登坂 正一、本社:東京都中央区)は、Bluetooth®(※1) 5 に対応した無線通信モジュール「EYSKBNZWB」(15.4x10.0x2.0mm)、「EYSLSNZWW」(3.25x8.55x1.0mm)を商品化します。これらの商品は、ウェアラブル端末やヘルスケア機器、物流端末など小型・薄型化が求められるIoT(注1)関連機器に最適な商品です。

今回商品化した「EYSKBNZWB」は、Bluetooth® 5で新たに追加されたロングレンジ(注2)機能に対応。この機能は長距離や電波が繋がりにくい環境で、無線通信の接続性を向上させ、通信距離を伸ばすことができます。

また「EYSLSNZWW」は、当社独自のシールドモールド(注3)技術を活用し、当社従来品「EYSLCNZWW」(9.6x12.9x2.0mm)から体積比で9割近くの小型化を実現しました。

これらの商品は、2018年9月から太陽誘電テクノソリューションズ株式会社(群馬県高崎市)にて量産開始予定です。当社サンプル価格は、いずれの商品も3,000円/個(※2)です。

IoT 関連機器は、センサネットワークなどを始め、極めて低消費電力で稼働することが求められます。また多種多様な用途やサイズ、環境で使用されるため、搭載される無線モジュールも多様なラインアップが求められます。そのような機器の多くには、低消費電力な無線通信規格としてBluetooth®が採用されています。最新バージョンのBluetooth® 5は、Bluetooth® V4.2の低消費電力という特長をそのままに、通信速度を2倍に、あるいは通信範囲を4倍まで拡大できるなど、さまざまなニーズに対応できる新たな機能が搭載されました。

これまで太陽誘電は、Bluetooth® 5に対応した無線通信モジュールを商品化してきました。今回、新たに無線通信モジュール「EYSKBNZWB」および「EYSLSNZWW」をそれぞれ商品化。これにより、サイズや機能などのラインアップを拡大し、お客様の開発する機器に最適な無線通信モジュールを提案できます。

今後も市場からのニーズに応え、高機能化・高信頼化など、さらなるラインアップ拡充を進めてまいります。

※1 Bluetooth®ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有しており、ライセンスに基づき太陽誘電株式会社が使用しています。

※2 掲載のサンプル価格は当社の販売サンプル価格です。代理店からご購入の場合は、各代理店へお問い合わせ下さい。

■用途

ウェアラブル端末やヘルスケア機器、物流端末など小型・薄型化が求められる IoT 関連機器向け無線通信モジュール。

■仕様

Part Number	Size (L×W×H)	RAM (kB)	Specification	I/F	Certification	Temperature	New Item
EYSKBNZWB	15.4×10.0×2.0mm	256	V5.0 BLE Single 2Mbps/ Long range	UART SPI I ² C PDM I2S USB	Japan U.S.A. Canada CE※	-40～ +85°C	★
EYSHCNZWZ	9.6×12.9×2.0mm	64	V5.0 BLE Single 2Mbps	UART SPI I ² C PDM			
EYSHJNZWZ	5.1×11.3×1.3mm			I2S			
EYSHSNZWZ	3.25×8.55×0.85mm						
EYSLCNZWW	9.6×12.9×2.0mm	24		UART SPI I ² C PDM			
EYSLSNZWW	3.25×8.55×1.00mm						★

※ ETSI EN 300 328 v2.1.1 の Conducted 試験報告書提供可

■用語解説

(注1) IoT (Internet of Things、モノのインターネット)

スマートフォンやウェアラブル機器をはじめ、自動車、産業機器などあらゆるものに通信機能が搭載され、インターネット接続や相互通信により、自動制御や遠隔管理などが行われること。

(注2) ロングレンジ

Bluetooth® 5 で新たに搭載された機能。通信速度が求められない用途で速度を遅くすることで、通信範囲を拡大させることができる。

(注3) シールドモールド

樹脂を用いたパッケージング技術の一種。当社の持つ材料技術を組み合わせ、樹脂モールドにシールド性を持たせることで、各回路の相互干渉対策を実現することができる。